

附件一

2023 年度总经理工作报告

各位董事：

现在，我代表公司管理层向董事会作总经理工作报告，请予审议！

一、2023 年工作回顾

2023年，公司法人治理体系构建完善、“三会”运作规范，期间共召开七次董事会、五次监事会、一次年度股东大会、两次临时股东大会。报告期内，公司加强内控规范和财务管理水平，在公司董事会领导下，经理层加大了规范管理、优化流程、内控治理、学习培训等规范工作力度。

纵观2023年，贸易摩擦对全球产业链布局产生的影响仍然持续。尽管受到了显著的宏观经济形势和竞争日趋激烈的环境压力，归功于国家对集成电路产业关注度不断提升，同时得益于公司研发项目不断加大投入，产品线不断丰富，大客户战略得到深化，小客户不断开发等多方面积极作用，公司的市场形象、品牌价值、核心竞争力得到了显著提升。公司积极部署研发战略和发展方向，贯彻落实年度经营计划，把握机遇，迎接挑战。面对复杂多变的外部环境，公司一方面及时调整经营策略，积极把握行业复苏和市场结构性增长机遇，创造条件满足市场需求，同时强化风险意识，增强客户服务能力和内部管理水平，灵活应对外部环境变化所带来的挑战和产生的机遇；另一方面继续加快技术创新步伐，扎实推进新产品推广和新产业基地建设，为公司中长期的健康、可持续发展奠定基础；此外，公司深入践行国际化发展战略，推动海外产能布局，有效应对全球格局变化所带来的影响。

报告期内，我们主要完成了以下工作：

（一）坚持自主研发，加大研发投入

公司始终坚持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注于测试机、分选机、探针台、AOI设备、自动化设备等专用平台的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能，同时加强研发

团队力量，同时与国内知名院校就业办加强了合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。以多年持续技术创新为基础，公司继续深化已掌握的集成电路测试设备的相关核心技术，报告期内，继续加大研发投入力度，2023年研发经费投入达研发投入78,779.43万元，占营业收入比例为44.38%，公司基于持续开拓高端市场的考虑，2023年研发投入较上年仍大幅上升。

（二）贯彻“以客户为中心”扩大销售规模

公司不断培养员工强化“以客户为中心”的文化理念，继续深化客户战略，服务好客户，加强市场推广力度，进一步提升公司品牌价值；巩固和提高现有客户销售规模，进一步提高公司在新增客户中的影响力和占有率，积极开发导入新的客户，立足国内市场的同时，积极开拓国际客户，报告期内公司继续开拓海外市场的同时，有序推进了新客户的导入工作，公司客户结构持续优化；同时，公司扩大了产品市场份额以及产品的应用领域，使公司在行业内的影响力得到进一步提升。

（三）长川内江主要生产基地第一阶段已初步建成

报告期内，公司在四川省内江市子公司长川科技（内江）有限公司主要生产基地第一阶段已初步建成。

（四）完成了发行股份购买资产收购长奕科技（马来西亚Exis）

报告期内，公司完成了发行股份购买资产收购长奕科技（马来西亚Exis），本次交易完成后，标的公司优质资产及业务进入上市公司。

（五）集成电路高端智能制造基地建设正常推进

报告期内，集成电路高端智能制造基地项目稳步建设。

（六）公司治理

报告期内，公司进一步健全了内部控制制度，完善了公司法人治理结构，修订了《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度，上述制度的制定或修订，进一步完善了公司治理结构，对公司的长远发展有着重要的意义。

（七）人才发展

人才是企业发展的根本动力，公司高度重视人才的力量，大力实施人才战略。

报告期内，公司开展新员工入职培训工作和导师培训工作，通过系统的培训，员工理念明显提升，管理技能得到加强。公司校招及社招一直有序进行，从外部招聘部分社招人才，并从一批985、211高校中挑选了大批优秀毕业生，为公司未来的可持续发展提供了人才保障。

二、2024年主要工作目标

（一）公司未来发展战略

根据半导体行业内“一代设备，一代工艺，一代产品”的经验，半导体产品制造要超前电子系统开发新一代工艺，而半导体设备要超前半导体产品制造开发新一代产品，公司秉承“诚信、务实、创新、高效”的企业文化精神，在将现有产品领域做专、做强，保持产品市场领先地位的基础上，重点开拓各类数字芯片测试设备、三温分选设备、AOI检测量测设备及封装相关设备等，不断拓宽产品线，并积极开拓中高端市场，将公司打造成提供国际一流的集成电路装备供应商。

公司在深入研究集成电路装备业发展规律、行业现状、市场需求和技术趋势的基础上，制定了“市场指导研发、研发提升产品、产品促进销售”的三维式立体发展模式：

1、产品深度方向。发挥现有核心技术优势，不断探索产品技术深度，力求将产品做精、做专，不断提高产品的市场竞争力；

2、产品线宽度方向。通过市场调研、产品规划、现有技术延展、新技术的研究，不断开发新的产品线，为公司的发展开拓新的增长点；

3、市场开拓方向。不断提升公司研发水平、产品品质，加强公司品牌建设，从中低端市场向中高端市场、从国内市场向国外市场开拓，将公司打造成为国际集成电路装备业的知名品牌。

（二）经营举措

为实现公司的未来发展战略，进一步提升可持续发展能力和核心竞争力，2024年围绕战略规划，公司制定了各项经营举措具体如下：

- 1、优化资源配置，扩大公司产能；
- 2、公司级PMO等体系建设；
- 3、加快高端智能制造基地的建设工作；

4、继续加大研发投入，加强技术创新和新产品开发，持续优化产品设计，提升企业竞争力；

5、强调以客户为中心，聚焦重点客户，布局主流客户，挖掘潜在客户，提升老客户，带动市场份额继续快速扩张；

6、注重人才管理，推行股权激励，完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的人才发展体系，引进市场优秀人才，关注员工的职业生涯管理，激发员工积极性，挖掘公司员工创造力和潜在动力；

7、加强内部管理，完善管理体系，注重风险控制，确保企业稳健成长；

8、持续加强企业价值管理，塑造品牌价值。

2024年公司经营管理团队将认真履责，努力进取以更加优异的经营业绩回报广大投资者。

请各位董事审议。

杭州长川科技股份有限公司

总经理：赵 轶

2024年4月23日